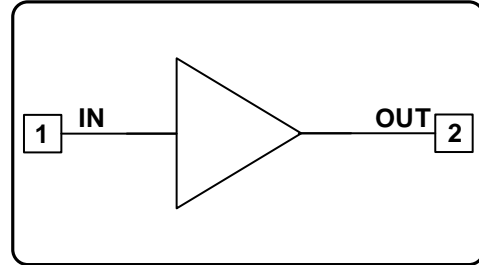




主要特点

- 工作频率: DC -4 GHz
- 增益: 16 dB
- 噪声系数: 2.3 dB
- 直流供电: +5V @ 95 mA
- 反向隔离: 20 dB
- P1dB: +21 dBm
- 芯片尺寸: 1×1×0.1 mm³

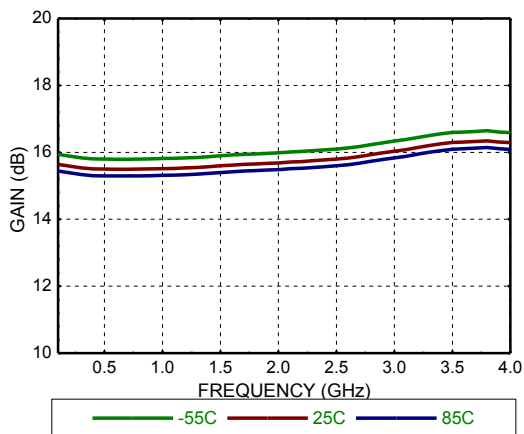
功能框图



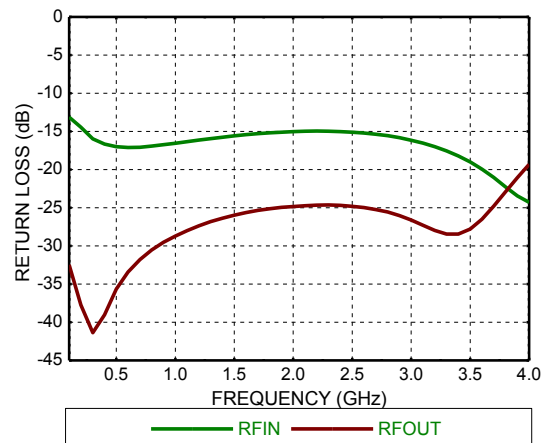
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = +5\text{ V}$, $I_{DD} = 95\text{ mA}$)

参数	最小	典型	最大	单位
工作频段	DC - 4			GHz
增益		16		dB
输入回波损耗		15		dB
输出回波损耗		20		dB
反向隔离度		20		dB
输出功率 1dB 压缩点		21		dBm
噪声系数		2.3		dB
输出 IP3		30		dBm
工作电流		95		mA

增益 vs. 温度

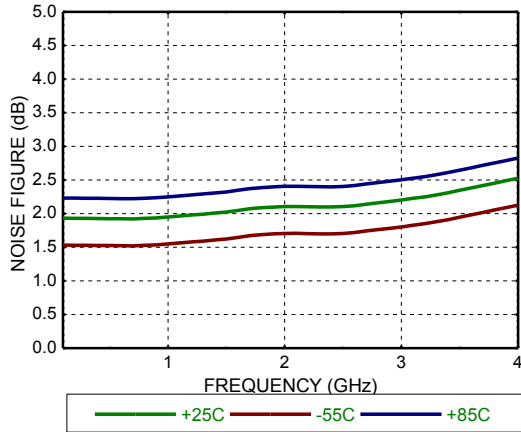


回波损耗

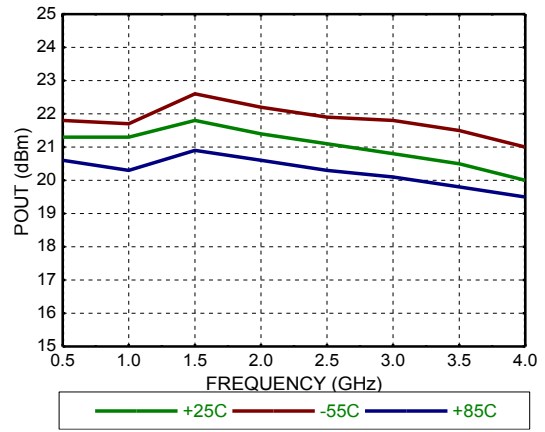




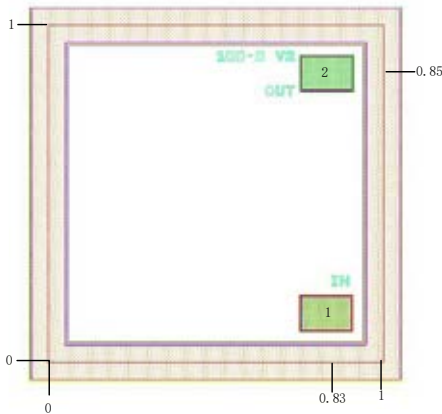
噪声系数



输出功率P1dB



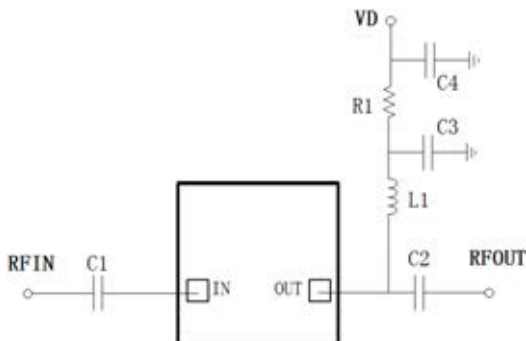
物理参数



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	该焊盘是 DC 耦合，片上无隔直电容，匹配至 50 Ohm
2	OUT	该焊盘是 DC 耦合，片上无隔直电容，匹配至 50 Ohm
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

推荐偏置电路



频率	50-500MHz	500-4000MHz
L1(nH)	330	68
C1,C2(pF)	1000	100
C3/C4(uF)	0.001/0.01	
R1(ohm)	0	

参考频率	500MHz	2000MHz	2500MHz	3500MHz
C1,C2(pF)	100	22	22	22
L1(nH)	82	22	18	15

极限参数

射频输入功率: +17dBm

储存温度: -65~+150℃

输出端口供电: +6V

工作温度: -55~+85℃